

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup i sukcesywną dostawę odczynników chemicznych**.

Zamawiający, Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. W związku z tym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy, jest:

Numer zadania	Nazwa odczynnika	CAS	Maksymalne zapotrzebowanie	Minimalna jednorazowa wielkość dostawy	Wymagane parametry techniczne
1.	Kwas fosforowy (H ₃ PO ₄)	7664-38-2	60L	❖ Co najmniej 3,5L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dla przemysłu elektronicznego semiconductor grade MOS; ❖ stężenie ≥85% ❖ Cząstki > 1.0 μm/ml <25 ❖ Zanieczyszczenia śladowe (w ppm): <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium < 0.020 • Wapń < 0.039 • Ołów <0.020 • Potas <0.020 • Sód <0.105 • Stront <0.020
2.	Kwas azotowy (HNO ₃)	7697-37-2	40L	❖ Co najmniej 3,5L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dla przemysłu elektronicznego semiconductor grade VLSI; ❖ stężenie ≥69% ❖ Pozostałości po odparowaniu <0,00025% ❖ Zanieczyszczenia śladowe: <ul style="list-style-type: none"> • German <0,000005% • Mangan <0,000001% • Molibden <0,000002% • Stront <0,000001%
3.	Kwas octowy (CH ₃ COOH)	64-19-7	30L	❖ Co najmniej 3,5L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Czystość co najmniej cz. d. a.; ❖ Stężenie 99-100% ❖ Temp. krzepnięcia min. 14,8 °C ❖ Pozostałości po odparowaniu maks. 0,002% ❖ Subst. redukujące KMnO₄ (j. HCOOH) maks. 0,02% ❖ Subst. redukujące K₂Cr₂O₇ : <ul style="list-style-type: none"> • Metale ciężkie (j. Pb) maks. 0,0001% • Żelazo maks. 0,00006% • Chlorki maks. 0,0001%
4.	Fluorek amonu (NH ₄ F)	12125-01-8	180L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ stężenie ≥40% ❖ Cząstki > 0.5 μm/ml <83 ❖ Fosforany (PO₄) <0,1 ppm

					<ul style="list-style-type: none"> ❖ Siarczany (SO₄) <1,0 ppm ❖ Pozostałości po odparowaniu <10ppm ❖ Zanieczyszczenia śladowe (w ppm): <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium <0,0011 • Wapń <0,015 • Żelazo <0,0041 • Magnez <0,001 • Srebro <0,001 • Sód <0,0041 • Arsen i Antymon (j. As) <0,001
5.	Fluorowódór (HF)	7664-39-3	40L	❖ Co najmniej 3,5L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ stężenie 49,5-50,5% ❖ Popiół siarczanowy <0,001% ❖ Srebro <0,0000005% ❖ Ołów <0,000001% ❖ Aluminium <0,00001%
6.	Woda amoniakalna (NH ₄ OH)	1336-21-6	100L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ Stężenie ≥25% ❖ Substancje redukujące <0,0005% ❖ Związki nietlotne <0,002% • Srebro <0,000002% • Kadm <0,000005% • Ołów <0,000005% • Cyrkon <0,001ppm • ISO, Ph. Eur. ±250 g NH₃ /kg
7.	Kwas solny (HCl)	7647-01-0	100L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ stężenie 30-50% ❖ Cząstki > 0.5 μm/ml <24 ❖ Wolne halogeny (jak Cl₂) - test zdany ❖ Fosforany (PO₄) <50 ppb ❖ Siarczany (SO₄) <500 ppb ❖ Siarczyny (SO₃) < 500ppb ❖ Zanieczyszczenia śladowe (w ppb): <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium <4 • Wapń <38 • Żelazo <9 • Magnez <4 • Srebro <1 • Sód <35
8.	Kwas siarkowy (H ₂ SO ₄)	7664-93-9	200L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ Stężenie 95-97% ❖ Pozostałości po odparowaniu <0,0005% ❖ Substancje redukujące <0,0002% ❖ Zanieczyszczenia śladowe: <ul style="list-style-type: none"> • German <0,000005% • Rtęć <0,000005% • Nikiel <0,000002% • Ołów <0,000002% • Tal <0,000005% • Wanad <0,000001%
9.	Woda utleniona (H ₂ O ₂)	7722-84-1	200L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ Stężenie ≥30% ❖ Metale ciężkie (j. Pb)<0,0005% ❖ Wolne kwasy <0,02% ❖ Fosforany ± 10ppm ❖ Chlorki <0,005% ❖ Związki nietlotne <0,02%

Zastępuje się zapisem:

Numer zadania	Nazwa odczynnika	CAS	Maksymalne zapotrzebowanie	Minimalna jednorazowa wielkość dostawy	Wymagane parametry techniczne
1.	Kwas fosforowy (H ₃ PO ₄)	7664-38-2	60L	❖ Co najmniej 3,5L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dla przemysłu elektronicznego semiconductor grade MOS; ❖ stężenie ≥85% ❖ Częstki > 1.0 μm/ml <25 ❖ Zanieczyszczenia śladowe (w ppm): <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium < 0.020 • Wapń < 0.039 • Ołów <0.020 • Potas <0.020 • Sód <0.105 • Stront <0.020
2.	Kwas azotowy (HNO ₃)	7697-37-2	40L	❖ Co najmniej 3,5L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dla przemysłu elektronicznego semiconductor grade VLSI; ❖ stężenie ≥69% ❖ Pozostałości po odparowaniu <0,00025% ❖ Zanieczyszczenia śladowe: <ul style="list-style-type: none"> • German <50 ppb • Mangan < 50 ppb • Molibden < 20 ppb • Stront < 20 ppb
3.	Kwas octowy (CH ₃ COOH)	64-19-7	30L	❖ Co najmniej 3,5L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Czystość co najmniej cz. d. a.; ❖ Stężenie 99-100% ❖ Temp. krzepnięcia min. 14,8 °C ❖ Pozostałości po odparowaniu maks. 0,002% ❖ Subst. redukujące KMnO₄ (j. HCOOH) maks. 0,02% ❖ Subst. redukujące K₂Cr₂O₇ : <ul style="list-style-type: none"> • Metale ciężkie (j. Pb) maks. 0,0001% • Żelazo maks. 0,00006% • Chlorki maks. 0,0001%
4.	Fluorek amonu (NH ₄ F)	12125-01-8	180L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ stężenie ≥40% ❖ Częstki > 0.5 μm/ml <83 ❖ Fosforany (PO₄) <0,1 ppm ❖ Siarczany (SO₄) <1,0 ppm ❖ Pozostałości po odparowaniu <10ppm ❖ Zanieczyszczenia śladowe (w ppm): <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium <0,0011 • Wapń <0,015 • Żelazo <0,0041 • Magnez <0,001 • Srebro <0,001 • Sód <0,0041 • Arsen i Antymon (j. As) <0,001
5.	Fluorowódor (HF)	7664-39-3	40L	❖ Co najmniej 3,5L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ stężenie 49,5-50,5% ❖ Popiół siarczanowy <0,001% ❖ Srebro <0,0000005% ❖ Ołów <0,000001% ❖ Aluminium <0,00001%
6.	Woda amoniakalna (NH ₄ OH)	1336-21-6	100L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ Stężenie ≥25% ❖ Substancje redukujące <0,0005% ❖ Związki nielotne <0,002%

					<ul style="list-style-type: none"> • Srebro < 20 ppb • Kadm < 50 ppb • Ołów < 50 ppb • Cyrkon < 0,001ppm • ISO, Ph. Eur. ±250 g NH₃ /kg
7.	Kwas solny (HCl)	7647-01-0	100L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ stężenie 30-50% ❖ Cząstki > 0.5 µm/ml <24 ❖ Wolne halogeny (jak Cl₂) - test zdany ❖ Fosforany (PO₄) <50 ppb ❖ Siarczany (SO₄) <500 ppb ❖ Siarczyny (SO₃) < 500ppb ❖ Zanieczyszczenia śladowe (w ppb): <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium <4 • Wapń <38 • Żelazo <9 • Magnez <4 • Srebro <1 • Sód <35
8.	Kwas siarkowy (H ₂ SO ₄)	7664-93-9	200L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ Stężenie 95-97% ❖ Pozostałości po odparowaniu <0,0005% ❖ Substancje redukujące <0,0002% ❖ Zanieczyszczenia śladowe: <ul style="list-style-type: none"> • German <0,000005% • Rtęć <0,0000005% • Nikiel <0,000002% • Ołów <0,000002% • Tal <0,000005% • Wanad <0,000001%
9.	Woda ulteniona (H ₂ O ₂)	7722-84-1	200L	❖ Co najmniej 18L	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Do przemysłu elektronicznego, semiconductor grade VLSI; ❖ Stężenie ≥30% ❖ Metale ciężkie (j. Pb)<0,0005% ❖ Wolne kwasy <0,02% ❖ Fosforany ± 10ppm ❖ Chlorki <0,005% ❖ Związki nielotne <0,02%

§ 5 ust. 6 wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ, jest:

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia powiadomienia.

Zastępuje się zapisem:

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest przeprowadzenie badań bądź testów, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na odpowiednie przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji, przy czym łączny okres rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w SIWZ.

W pkt 20. Miejsce i termin składania ofert - jest

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleczki 19 w Warszawie, w pokoju nr 2.17 **do dnia 11.05.2017 r. do godz. 13.00. UWAGA!** Wejście wyłącznie w asyście upoważnionego pracownika Zamawiającego po zgłoszeniu w recepcji budynku.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

Zastępuje się zapisem:

W pkt 20. Miejsce i termin składania ofert

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleczki 19 w Warszawie, w pokoju nr 2.17 **do dnia 15.05.2017 r. do godz. 13.00. UWAGA!** Wejście wyłącznie w asyście upoważnionego pracownika Zamawiającego po zgłoszeniu w recepcji budynku.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

W pkt 21 – jest:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Laboratorium Centralnym CEZAMAT przy ul. Poleczki 19 w Warszawie, przeszklona sala rozmów w lobby na I piętrze budynku administracyjnego Laboratorium Centralnego CEZAMAT, w dniu **11.05.2017 r., o godzinie 13.15.**

Zastępuje się zapisem:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Laboratorium Centralnym CEZAMAT przy ul. Poleczki 19 w Warszawie, przeszklona sala rozmów w lobby na I piętrze budynku administracyjnego Laboratorium Centralnego CEZAMAT, w dniu **15.05.2017 r., o godzinie 13.15.**

Powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej w tym postępowaniu, są dla Wykonawców wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia.

Załącznik: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji SIWZ

**Kierownik Laboratorium Centralnego
CEZAMAT**

/-/

Mariusz Wielec